TAIMIDE

Taiwan Polyimide

We know Polyimide

法說會報告資料

Kevin Chen/Janifer Huang/Paul S. C. Wu

Nov. 06, 2026

CONFIDENTIAL

免責聲明

本簡報係由達邁科技股份有限公司(以下簡稱本公司)提供，本簡報可能包含前瞻性陳述，當中涉及風險與不明朗因素包括陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：經營上的改變、競爭環境、經濟情勢、法規變化、科技發展與超出本公司管控等因素，皆可能導致本公司實際營運結果與上開前瞻性陳述有很大的差異。本公司不承擔因情勢變更而即時更新或修正相關內容之義務。

本簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約，邀約之引誘或建議。本公司已盡合理之注意，使本簡報於公開時無任何不真實或誤導。本公司及其各關係企業代表人或董事，均不對此使用或因他人引用本份簡報資料、或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。

CONFIDENTIAL

TAIMIDE

公司簡介

2026年Q1~Q3營運情形

未來布局

問題與交流

CONFIDENTIAL

公司簡介

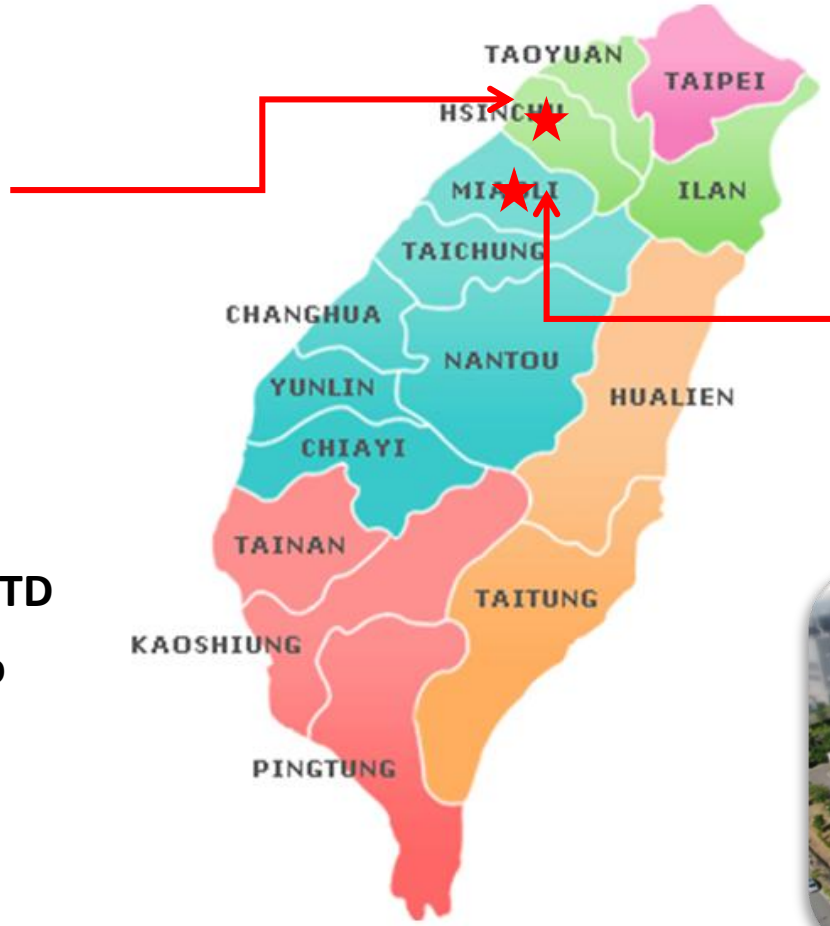
報告者:陳岱村副總經理

CONFIDENTIAL

Company Profile 簡介

TAIMIDE





Polyimide Film Manufacturer

- **Established: June, 2000**
- **Company capital: ~1,370M NTD**
- **Plant sites: Hsinpu & Tongluo**
- **Employees: ~500(含PMR)**
- **IPO in TSE: October, 2011**



2026年Q1~Q3營運情形

CONFIDENTIAL

綜合損益表

單位：新台幣佰萬元

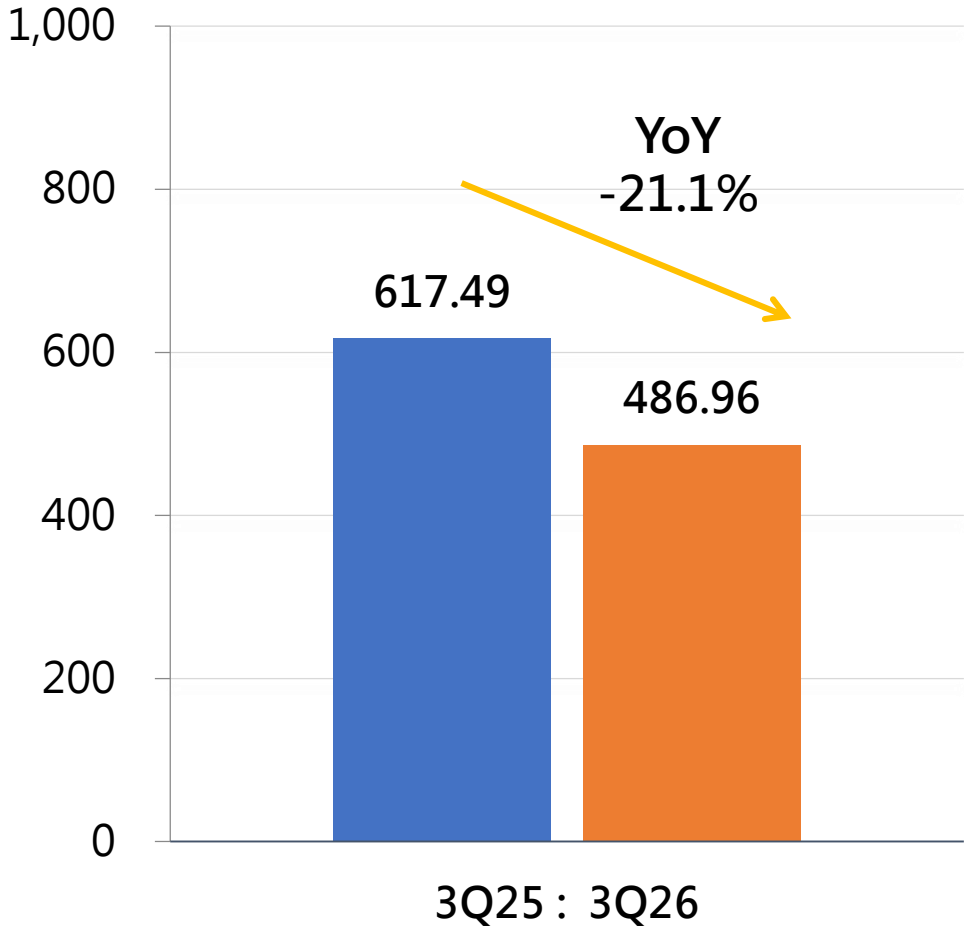
綜合損益表項目	3Q26	3Q25	YT3Q26	YT3Q25	去年同季變化	年變化
營業收入淨額	486.96	617.49	1,731.66	1,814.70	-21.1%	-4.6%
營業毛利	109.80	153.14	579.91	462.53	-28.3%	25.4%
營業毛利率	22.5%	24.8%	33.5%	25.5%	-2.3ppts	8.0ppts
營業費用	92.63	104.28	298.11	272.03	-11.2%	9.6%
營業利益	17.17	48.86	281.80	190.50	-64.9%	47.9%
營業淨利率	3.5%	7.9%	16.3%	10.5%	-4.4ppts	5.8ppts
營業外收入及支出	(0.98)	27.39	14.70	(40.98)	-103.6%	N/A
稅前淨利	16.19	76.24	296.50	149.53	-78.8%	98.3%
所得稅費用	14.47	15.40	93.94	29.77	-6.0%	215.5%
合併本期淨利	1.72	60.85	202.56	119.75	-97.2%	69.1%
純益率	0.4%	9.9%	11.7%	6.6%	-9.5ppts	5.1ppts
每股盈餘(新台幣元)	0.04	0.47	1.57	0.94	-91.5%	67.0%

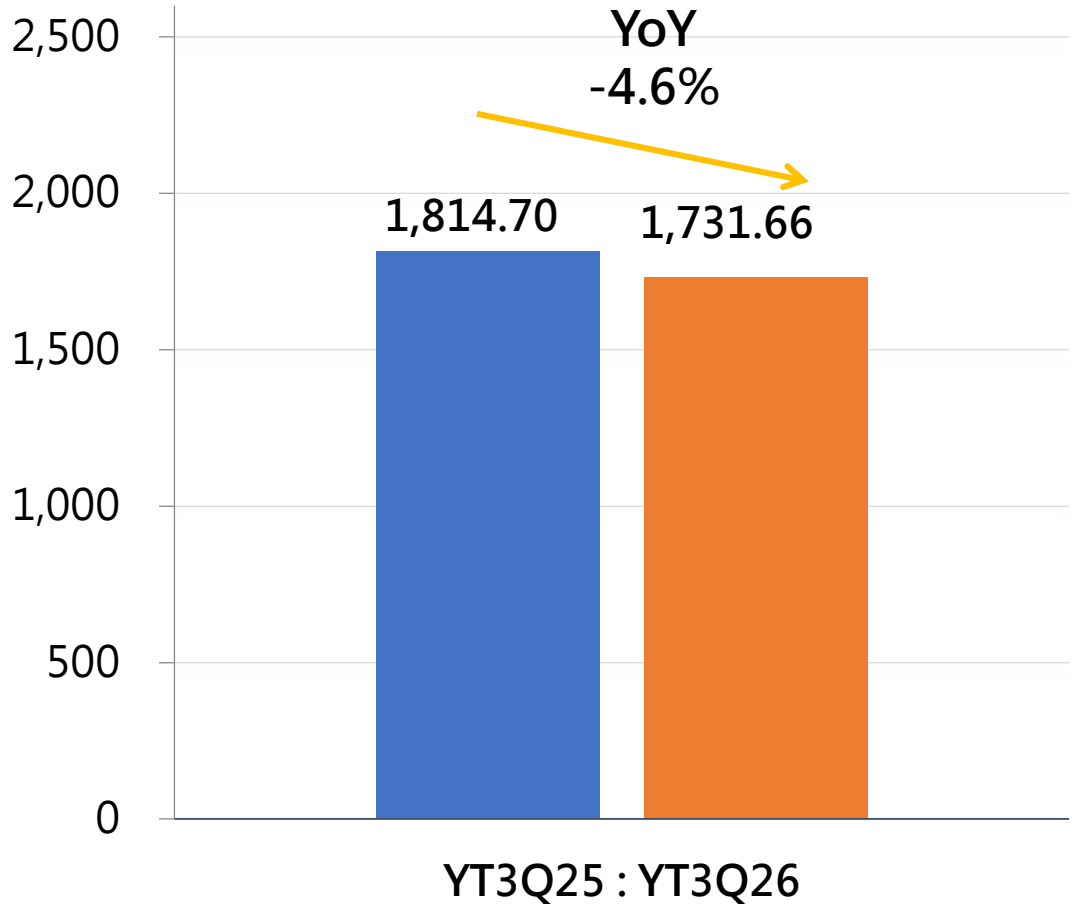
*2026年第三季加權平均流通在外股數為137佰萬股

CONFIDENTIAL

合併營業收入

單位：新台幣佰萬元

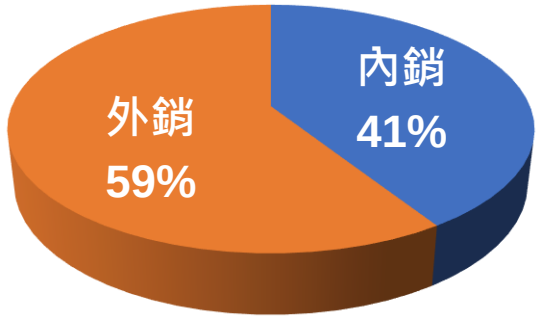




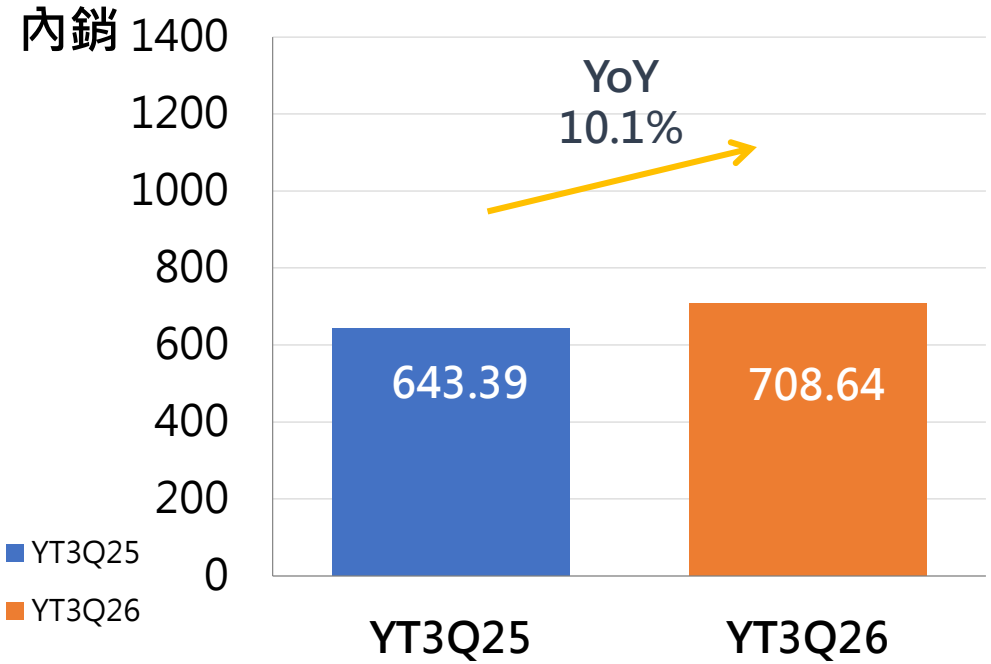
CONFIDENTIAL

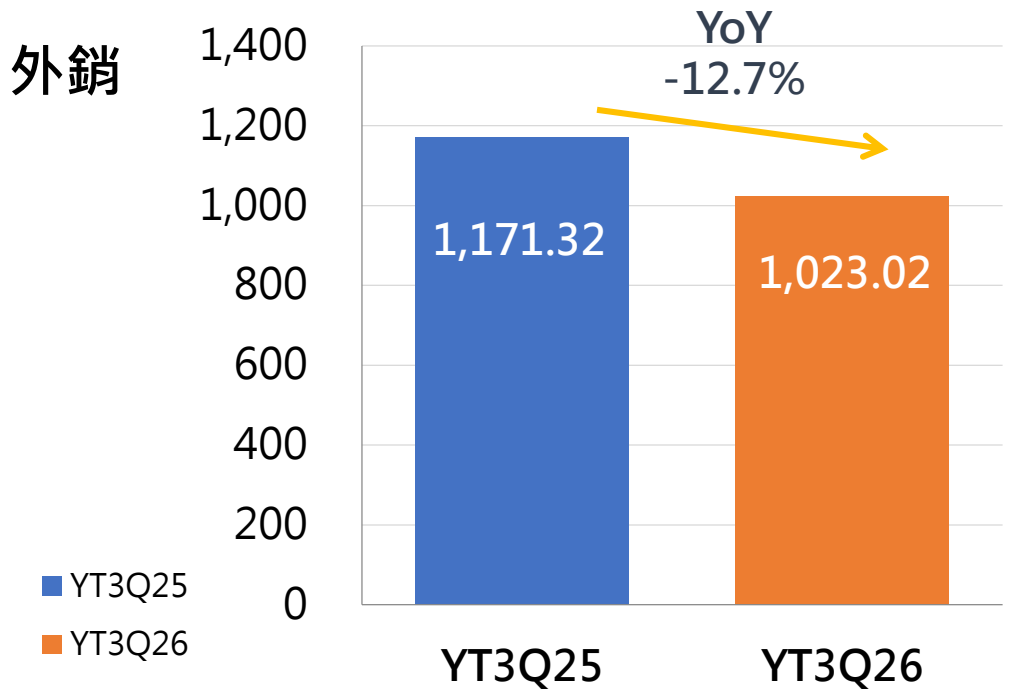
銷售市場

2026年Q1~Q3



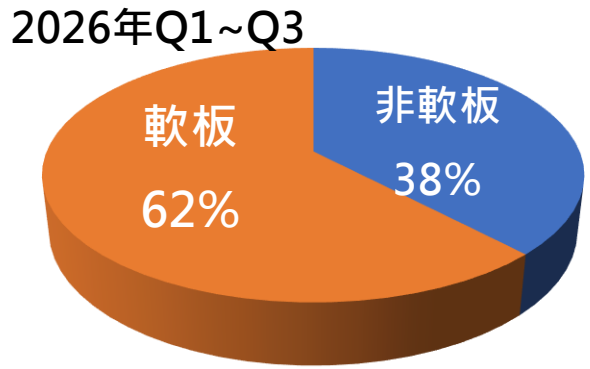
單位：新台幣佰萬元



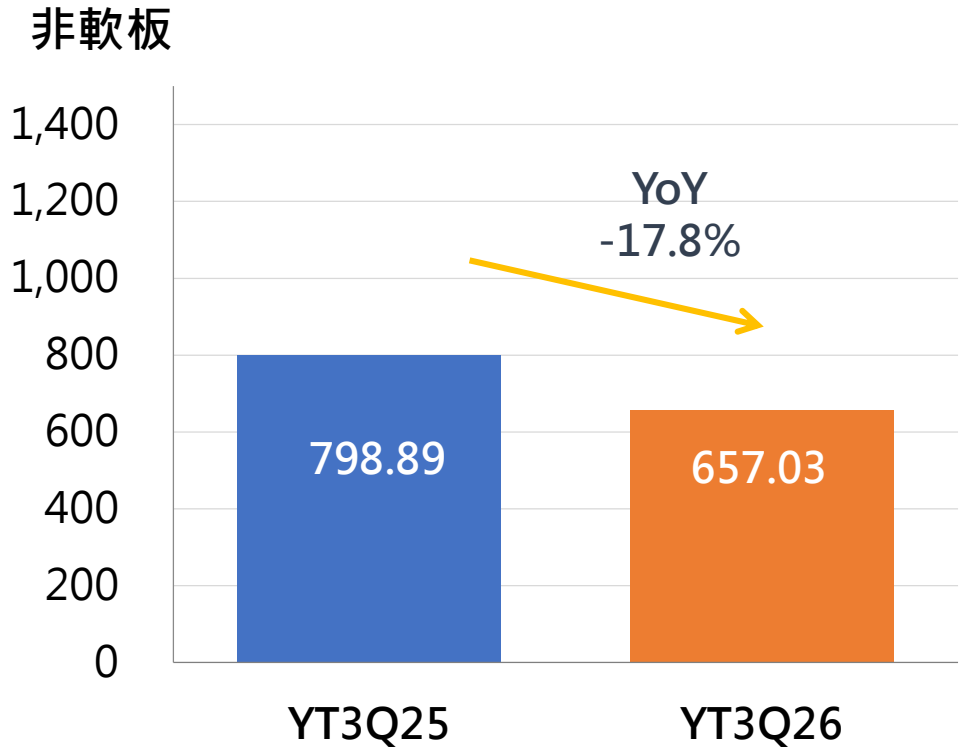


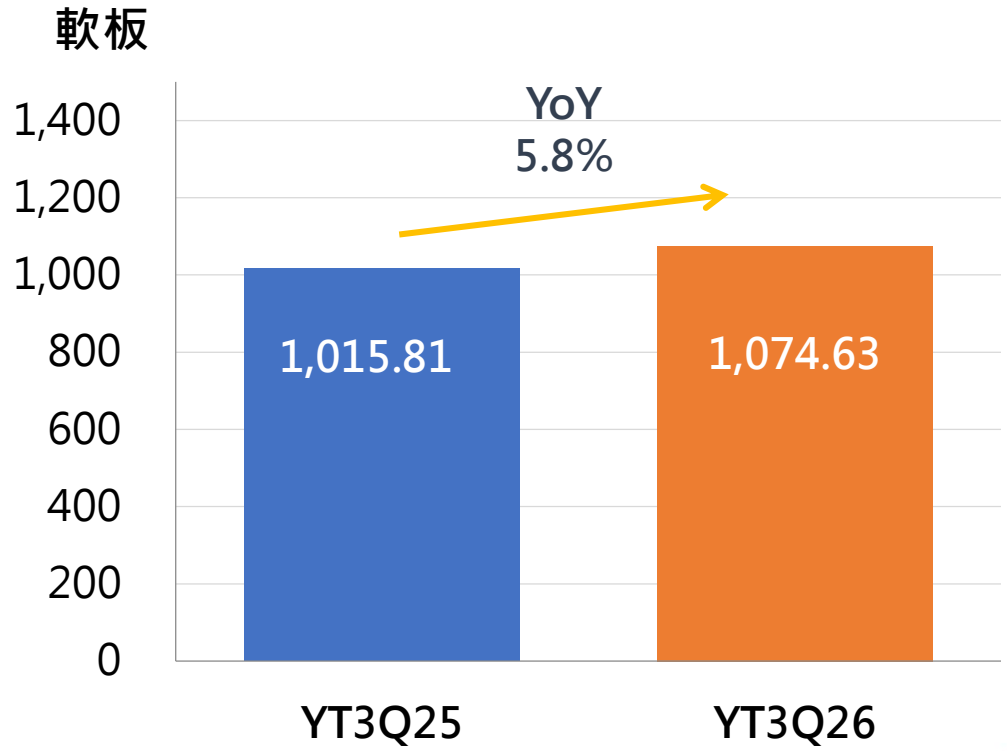
CONFIDENTIAL

應用市場



單位：新台幣佰萬元

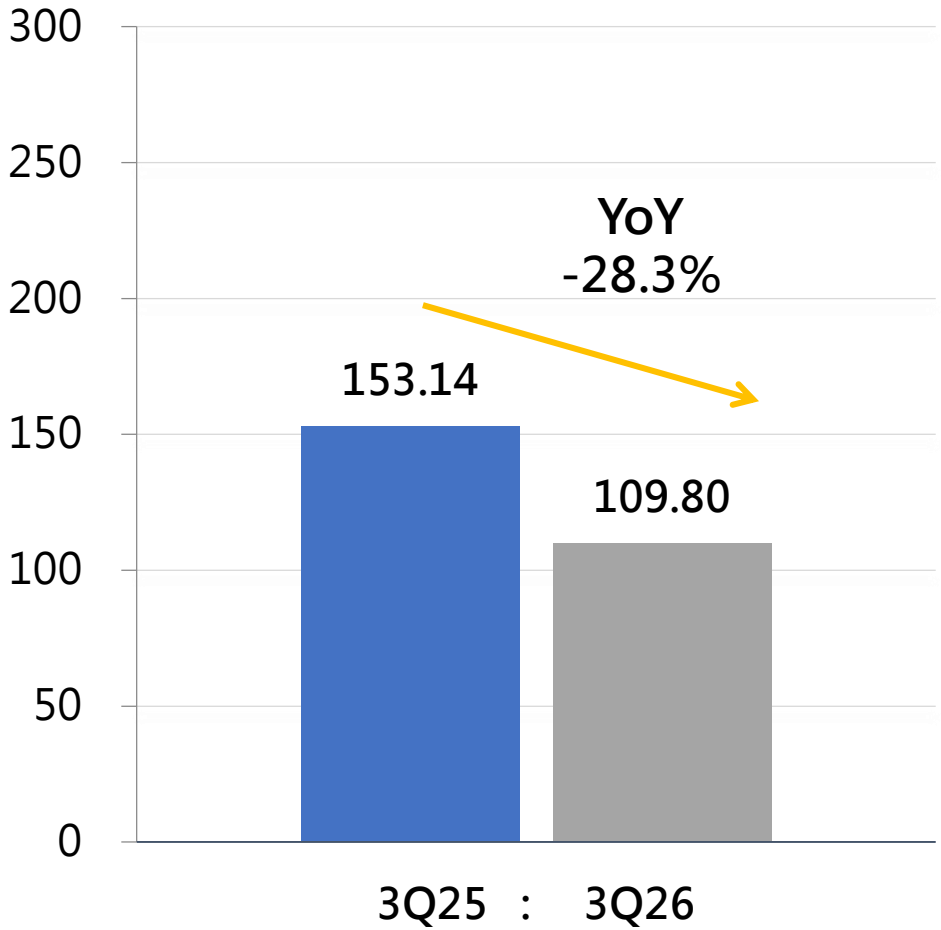




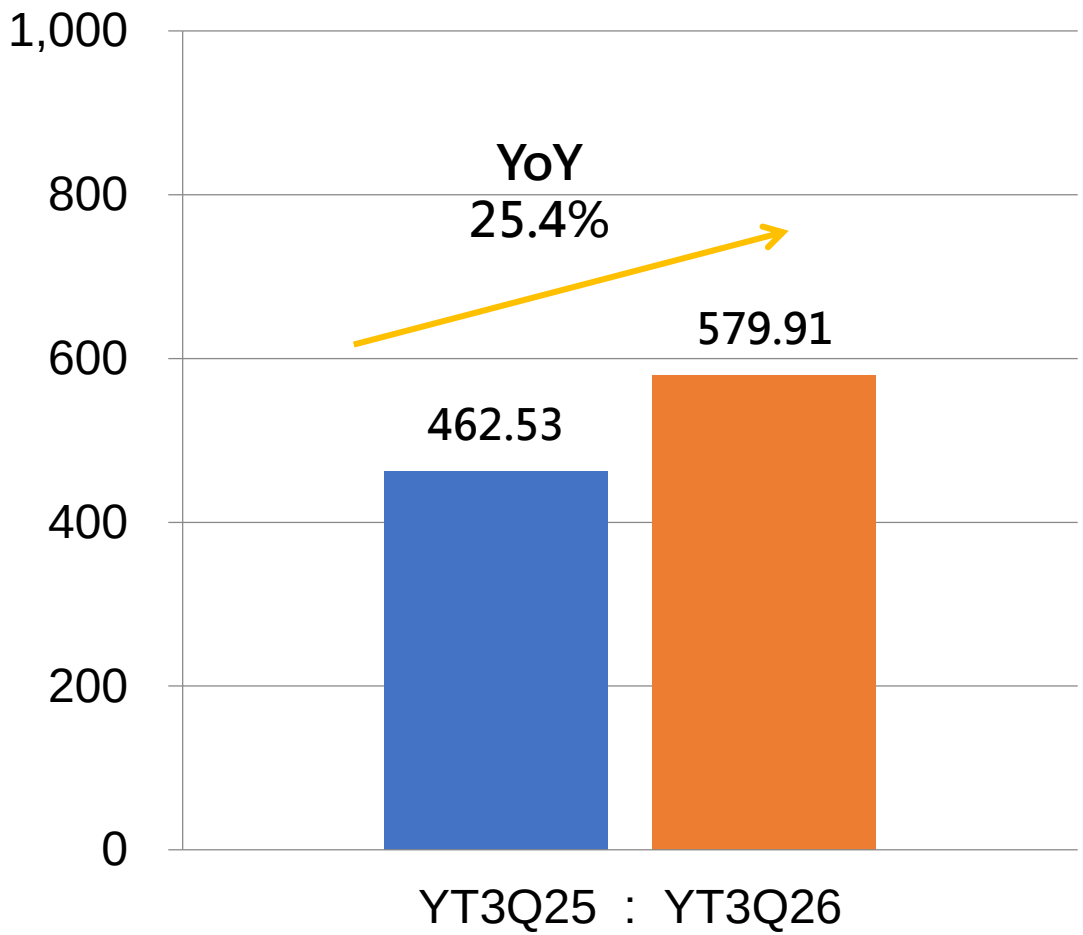
CONFIDENTIAL

合併營業毛利及毛利率

單位：新台幣佰萬元



合併毛利率：	24.8%	22.5%

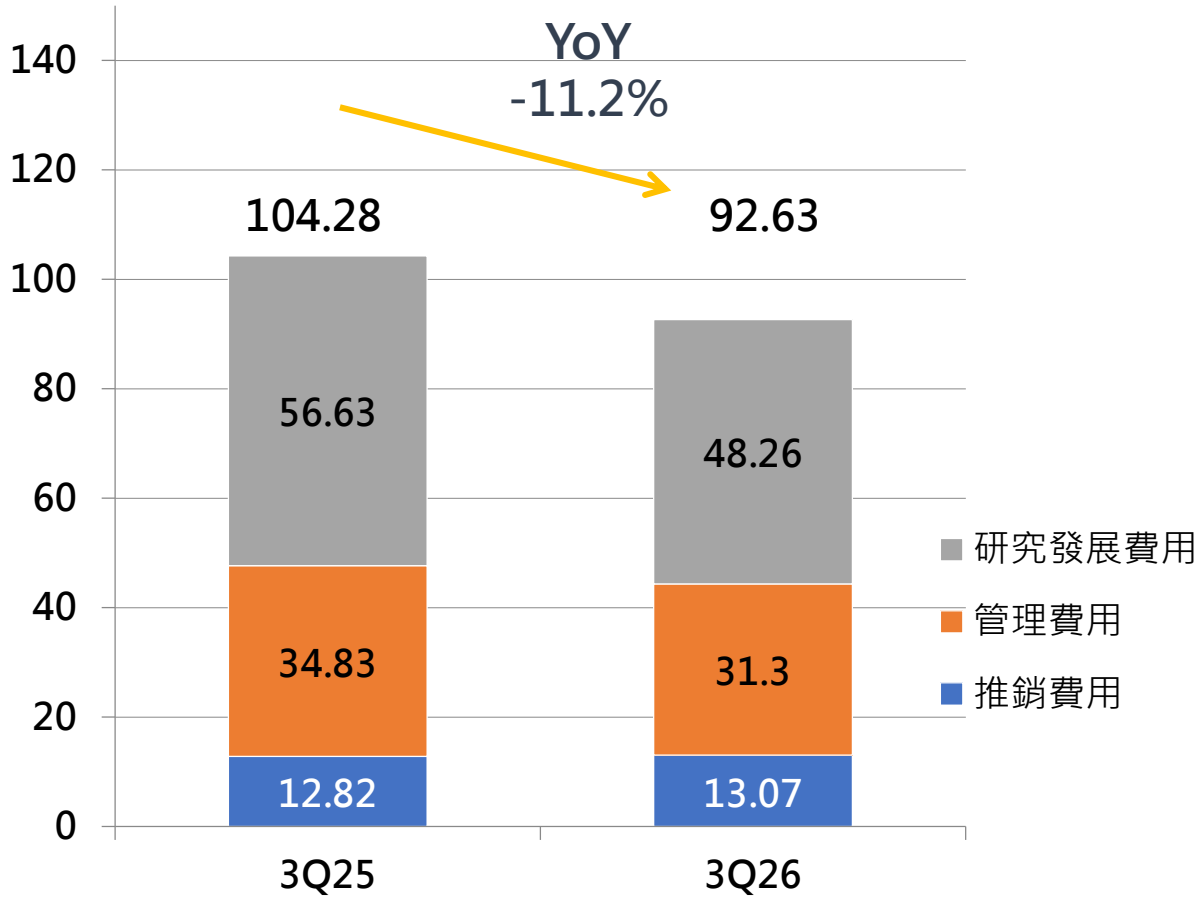


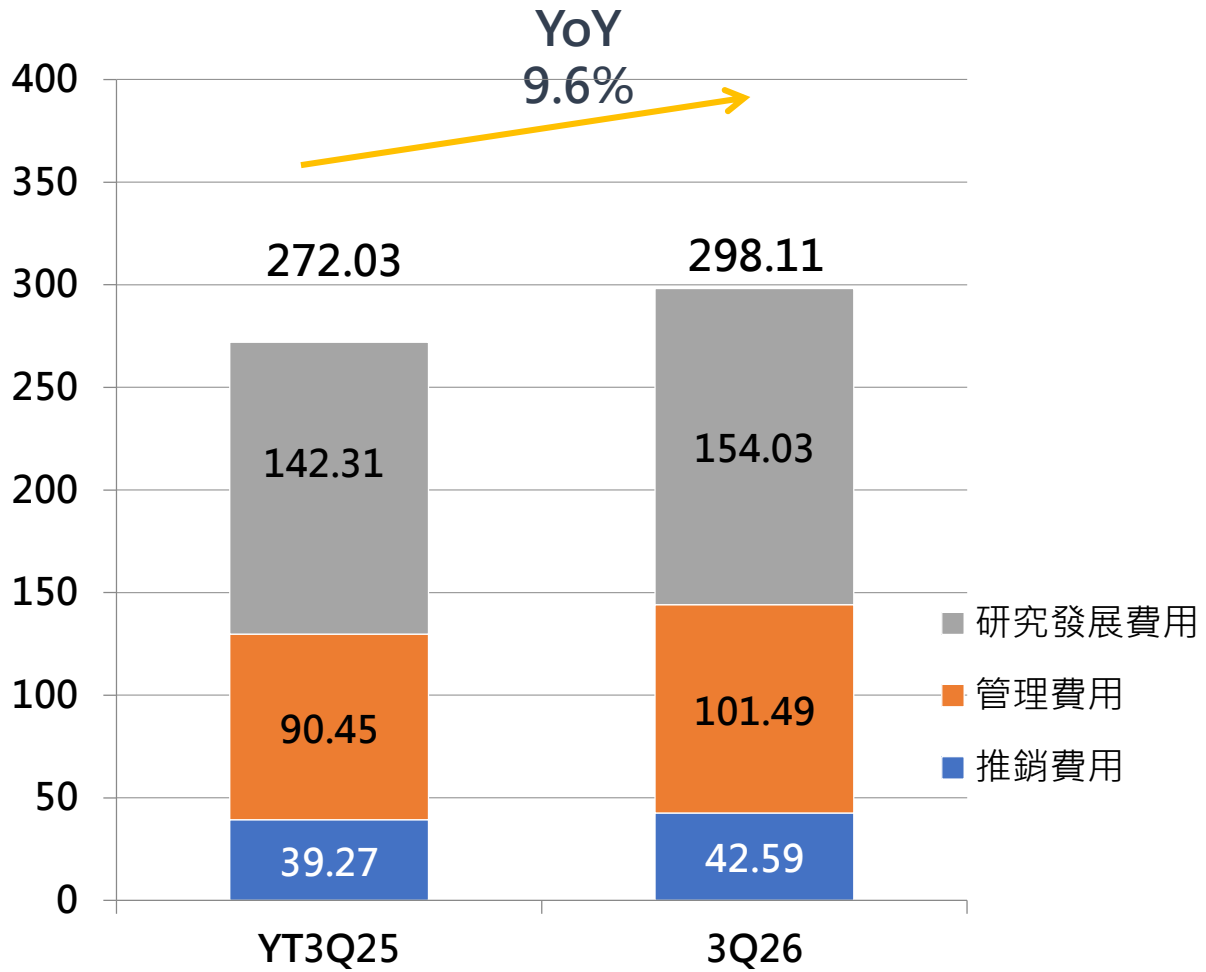
合併毛利率：	25.5%	33.5%

CONFIDENTIAL

合併營業費用

單位：新台幣佰萬元

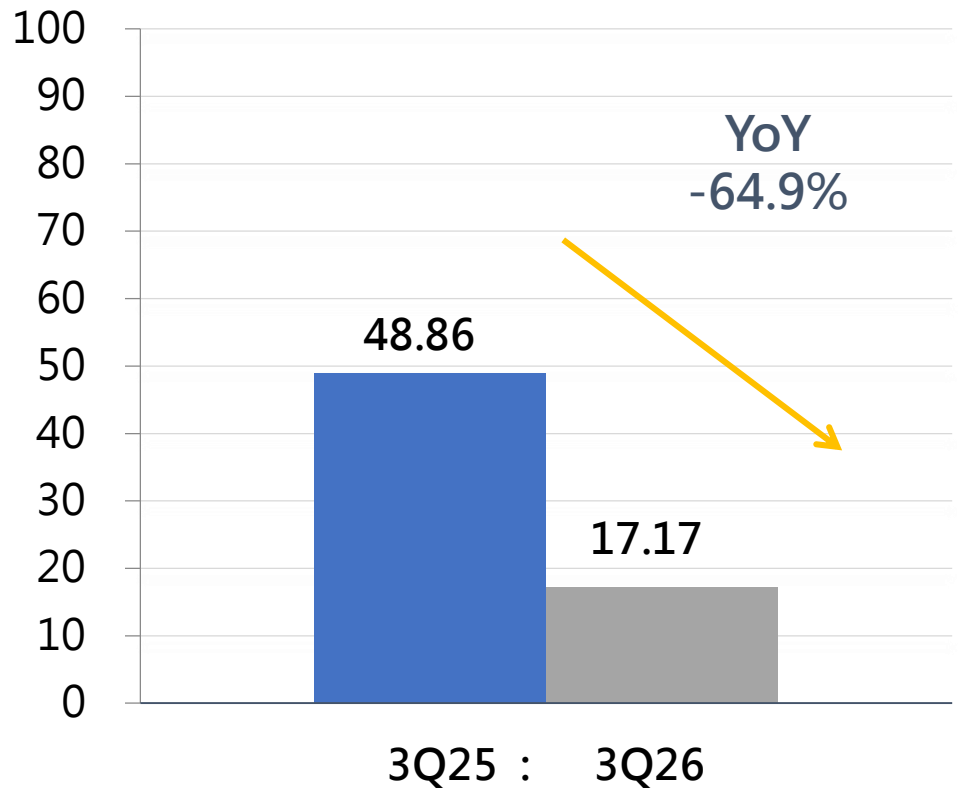




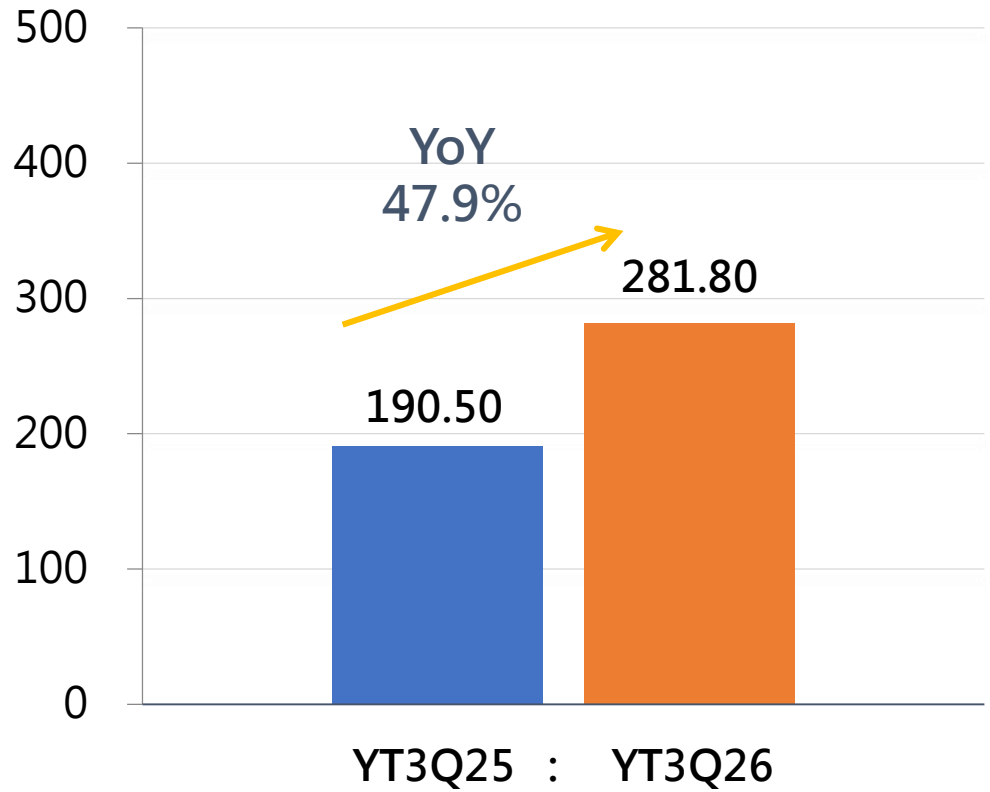
CONFIDENTIAL

合併營業利益及利益率

單位：新台幣佰萬元



合併營業利益率：	7.9%	3.5%

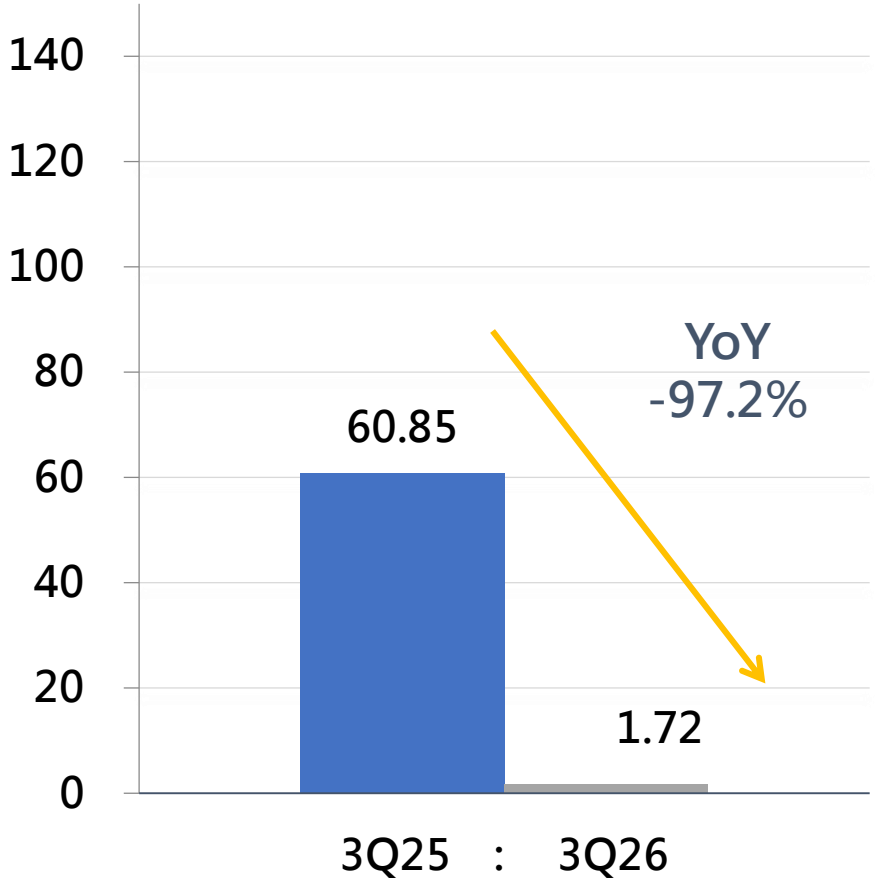


合併營業利益率：	10.5%	16.3%

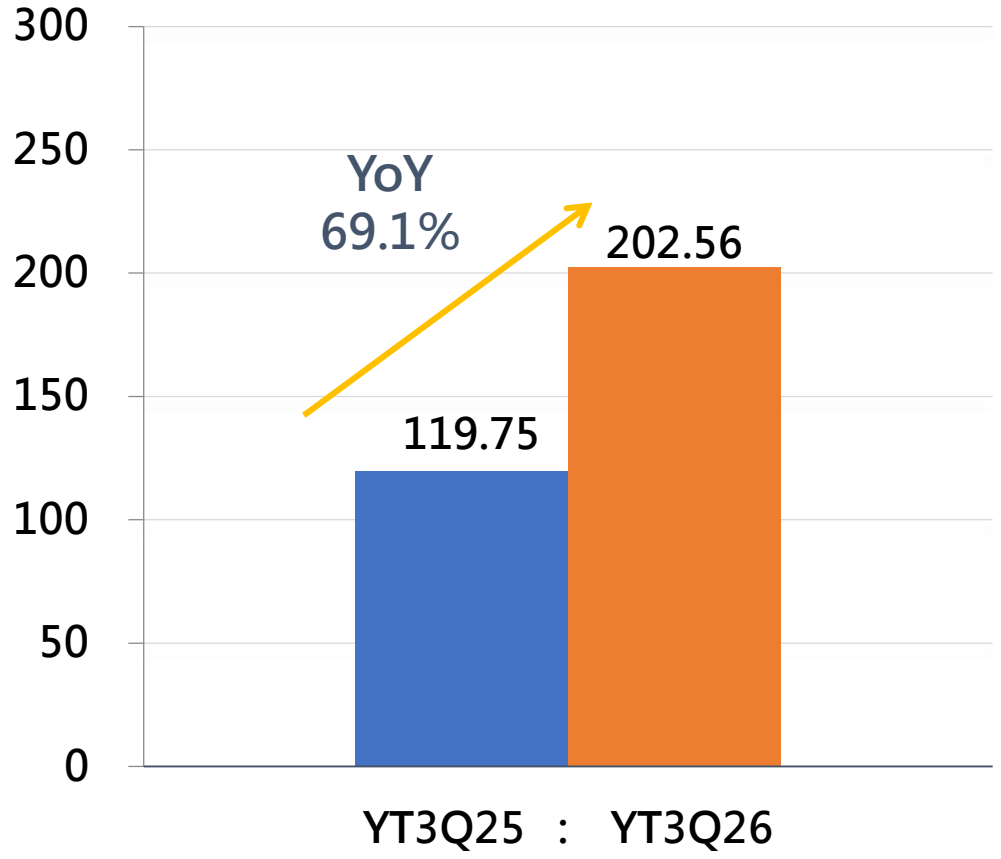
CONFIDENTIAL

合併本期淨利、淨利益率及EPS

單位：新台幣佰萬元



淨利益率：	9.9%	0.4%
EPS：	0.47	0.04



淨利益率：	6.6%	11.7%
EPS：	0.94	1.57

CONFIDENTIAL

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目	3Q26		2Q26		1Q26		3Q25	
單位：新台幣佰萬元	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金及有價金融商品投資	380.62	7.4%	626.72	11.9%	581.68	11.6%	666.90	13.2%
應收帳款	614.88	12.0%	697.03	13.3%	621.58	12.4%	724.79	14.4%
存貨	505.73	9.8%	431.08	8.2%	335.30	6.7%	315.18	6.2%
不動產、廠房及設備	3,177.73	61.8%	3,037.91	57.8%	2,973.82	59.4%	2,913.02	57.7%
其他資產	466.46	9.0%	461.21	8.8%	493.71	9.9%	428.26	8.5%
資產總計	**5,145.42**	**100.0%**	**5,253.95**	**100.0%**	**5,006.09**	**100.0%**	**5,048.15**	**100.0%**
流動負債	985.08	19.1%	1,234.81	23.5%	846.06	16.9%	856.50	17.0%
長期計息負債	706.66	13.7%	562.81	10.7%	647.82	12.9%	840.77	16.7%
其他負債	95.39	1.9%	100.61	1.9%	106.42	2.2%	118.00	2.3%
負債總計	**1,787.13**	**34.7%**	**1,898.23**	**36.1%**	**1,600.30**	**32.0%**	**1,815.27**	**36.0%**
權益總計	**3,358.29**	**65.3%**	**3,355.72**	**63.9%**	**3,405.79**	**68.0%**	**3,232.88**	**64.0%**
重要財務指標								
平均銷貨日數	99.54		90.67		79.28		79.34	
流動比率(倍)	1.63		1.50		1.93		2.08	
資產生產力(倍)	0.76		0.78		0.78		0.79	

*2026年第三季加權平均流通在外股數為137佰萬股

**資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

CONFIDENTIAL

公司發展策略 & 布局未來

第一章

報告者:黃貞英總經理

CONFIDENTIAL

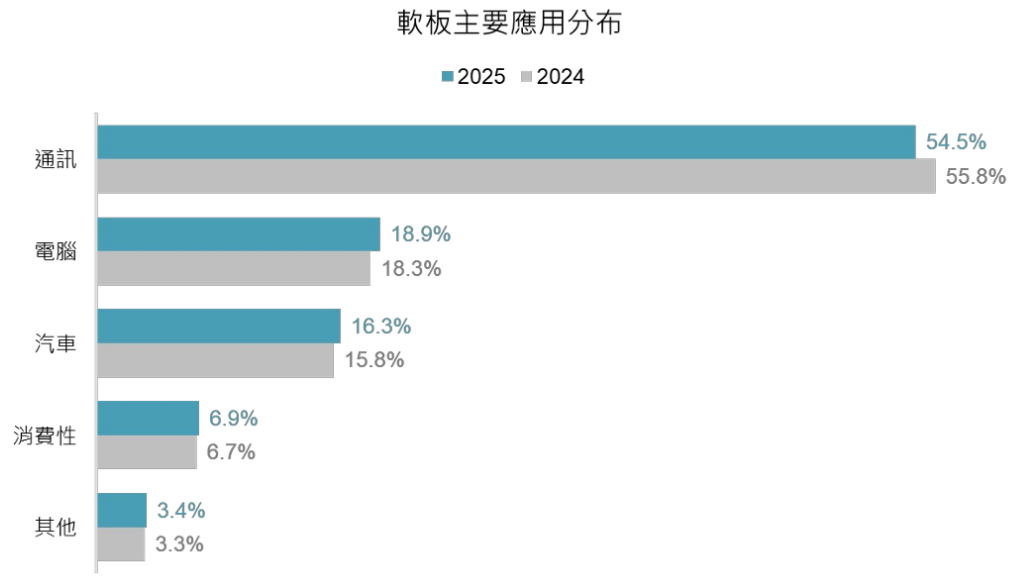
一、市場展望

AI的發展不僅需要算力，更需要多元的硬體載體，從AI伺服器、手機、電腦到電動車、智慧眼鏡與機器人，AI應用的擴張將持續帶動高性能電子材料的需求與技術升級!

CONFIDENTIAL

二、軟板主要應用分佈

- 手機佔整體軟板應用的50%以上，因此，TMT的重點是朝消費電子產品，尤其是手機所需的高性能PI材料方向發展。

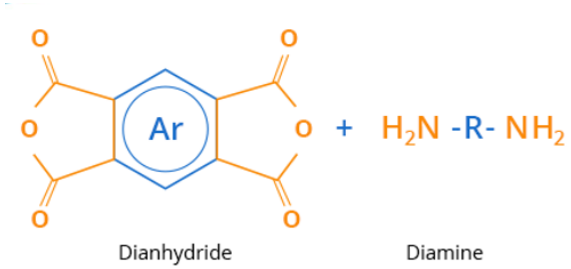


資料來源：TPCA & 工研院產科國際所

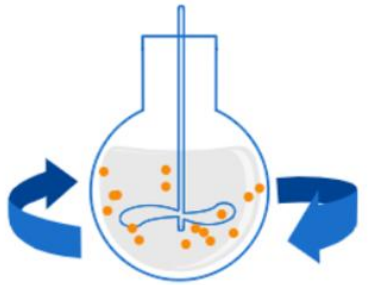
CONFIDENTIAL

三、薄型化PI Film

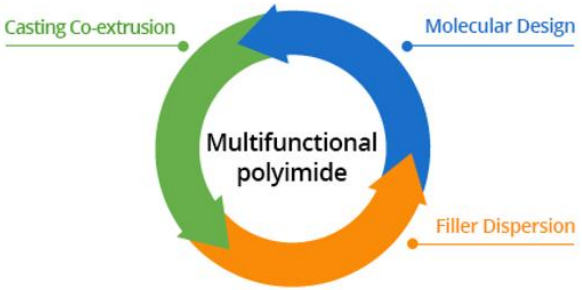
- 既要薄，又要特性優異
- 黑色5umPI的量產品在同業中被日本客戶評價為第一



Molecular Design


Filler Dispersion


Casting Co-extrusion



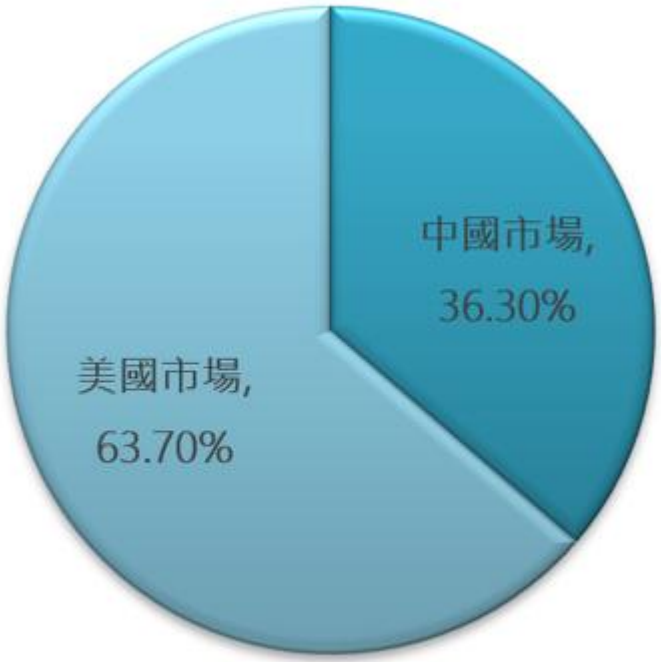
Customization

✓2027年將會出現首支有黑色5umPI的手機

CONFIDENTIAL

四、更厚 / 更高性能的PI Film (石墨膜,散熱應用)

- 高性能PI銷售佔比：2025年 43.6%；2026年(Q1~Q3)80.1%
- 全球高性能PI佔比：14%



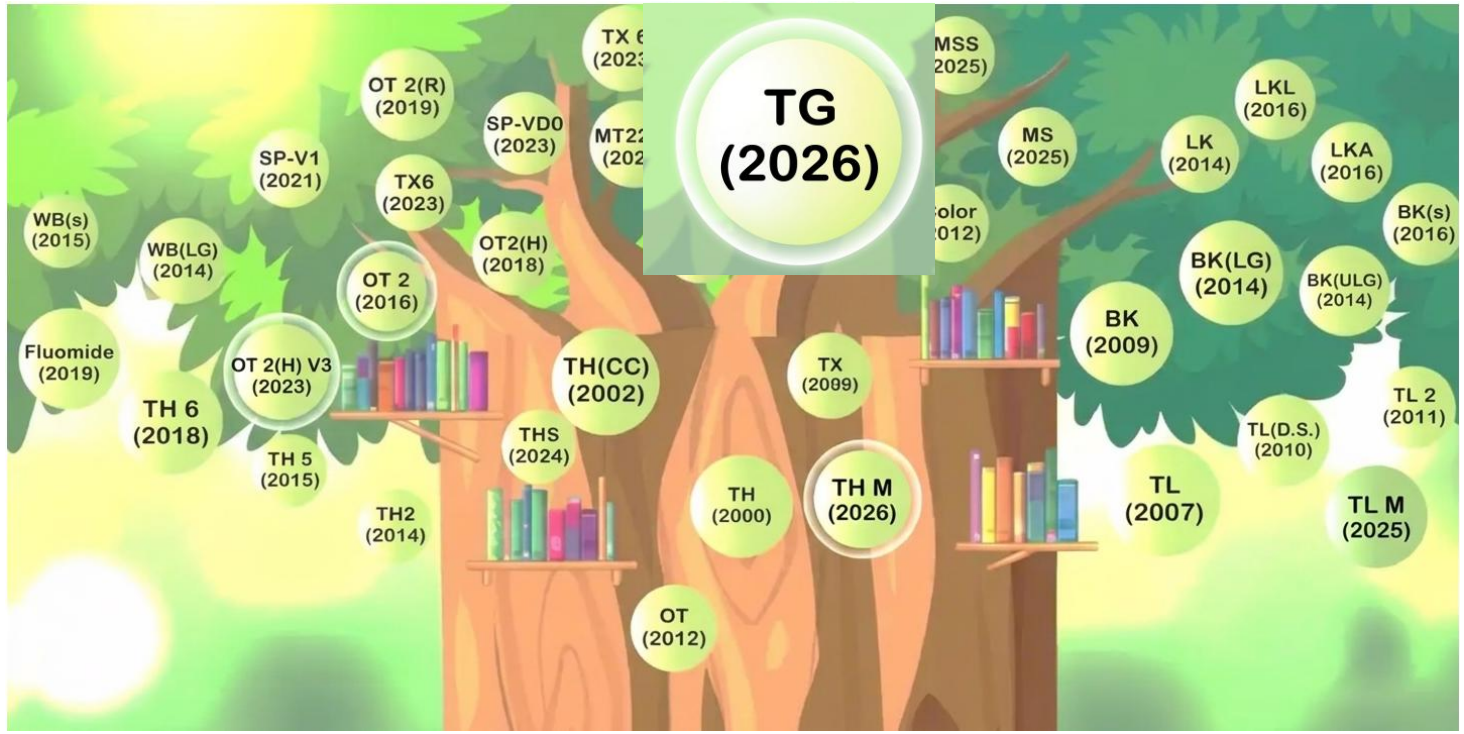
全球高性能石墨膜用PI佔比

✓ 目標明確，朝美國市場的方向前進!

CONFIDENTIAL

五、更多元

- 半導體：持續穩定出貨，同時和客端繼續開發先進封裝製程應用的PI膜。
- CCL：軟板、硬板相互靠攏，因應CCL客戶的特殊特性要求開發的PI Film，目前在台、日客端的評比中均名列前茅



公司發展策略 & 布局未來

第二章

報告者:吳聲昌董事長

CONFIDENTIAL

世局多變的經營環境

- 不可預測的國際局勢
  - ① 地緣政治的瞬息萬變 (區域戰爭的持續、美中台經濟、國安、科技角力.....)
    - a. 貿易壁壘逐漸高築
    - b. 生產基地 2+1布局規劃
  - ② AI 人工智慧的深度進化、引領未來社會活動變化的不確定性
- 必須面對的全球暖化、氣候變遷議題
  - ① 碳足跡的盤點、淨零碳排、碳中和、碳稅開徵帶來的企業經營衝擊
- 達邁思考的對應之道

  持續深耕 PI 薄膜，擴展跨領域合作，布局下一世代產業需求所需PI

CONFIDENTIAL

雙十展翼、再創新局 (第七講) (since 2020)

第六講 前情提要 → PFAS Free 危機就是轉機：從零開始的另外兩支硬翅膀

A. 兩支硬翅膀的 布局

a. 第一支翅膀: Fluomide® for 5G

b. 第二支翅膀: OPI® for Foldable AMOLED

B. VCP 的發展 策略

達邁新格局: Not only PI film Manufacturer，but also a Value Chain Provider (VCP)

擴展跨領域合作，布局下一世代產業需求所需 PI 膜

CONFIDENTIAL

主題

一、 從太平洋彼岸吹起的 東風

來看達邁的雙十展翼、再創新局

二、護國神山群：從Advanced IC Package、載板、印刷電路板

來看達邁的 VCP異質整合

三、 從柏彌蘭(PMR)金屬化的超微細電路

來看達邁異質整合VCP

CONFIDENTIAL

從太平洋彼岸吹起的 東風　來看達邁的 雙十展翼、再創新局

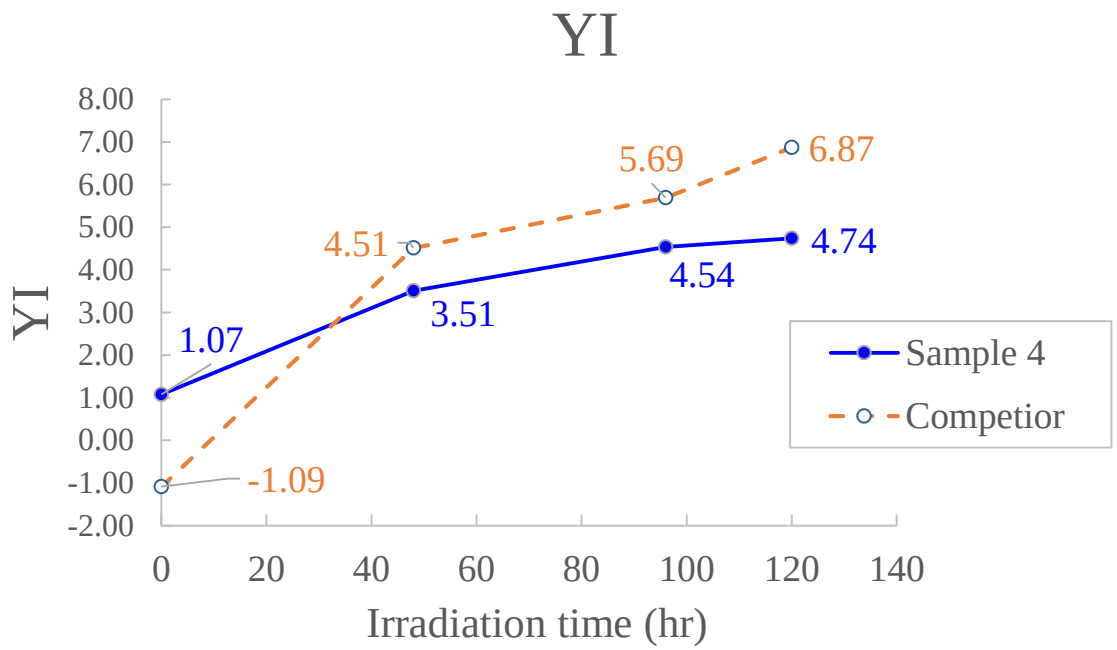
- 超薄、折疊的需求 (I-phone Duo)
  - 散熱要更好 — THK, THS 燒製成的高導熱石墨膜
  - FPC要更薄 — MSH-005 製成的超薄黑色Coverlay
  - 顯示屏折痕要消除的需求— PFAS Free OT2-V3 表面處理的UTG保護膜
  - 主板要更輕薄短小 (細線寬距、微小通孔) — TG 異質整合的載板、印刷電路板

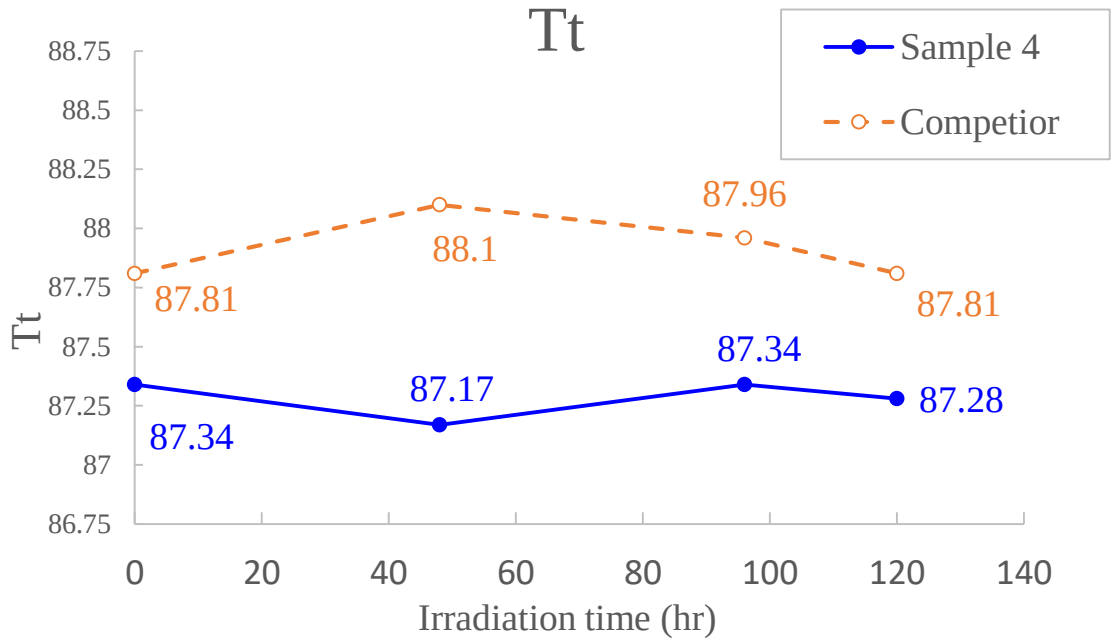
CONFIDENTIAL

PFAs-Free OT2 V3 For Foldable AMOLED

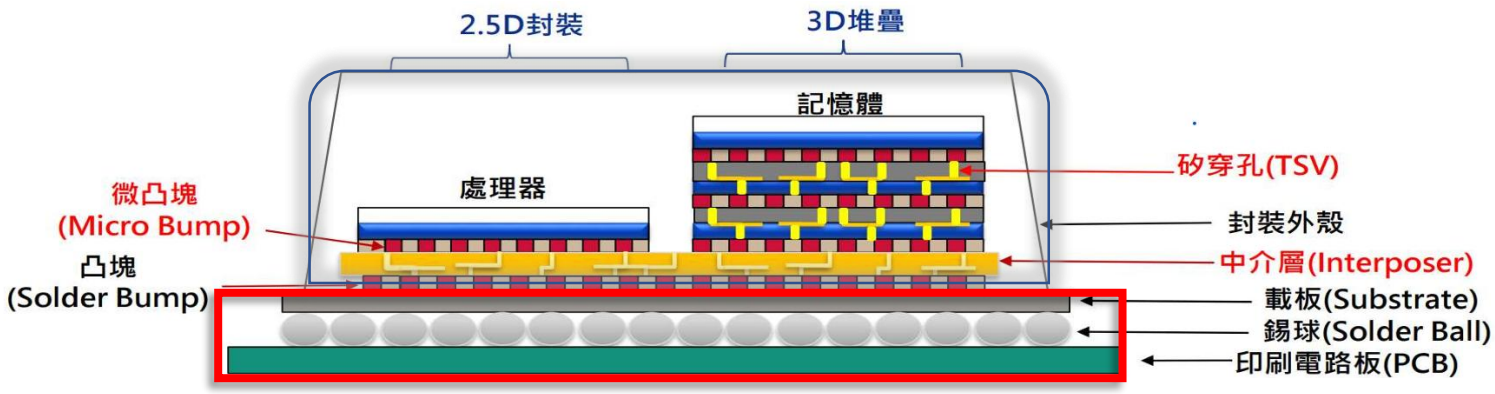
Light Yellowing (黃變) Resistance Test

Test condition:
Temperature: 55℃
Power: 0.8 W
light wavelength: 340nm





護國神山群：從Advanced IC Package、載板、印刷電路板看達邁的 VCP異質整合

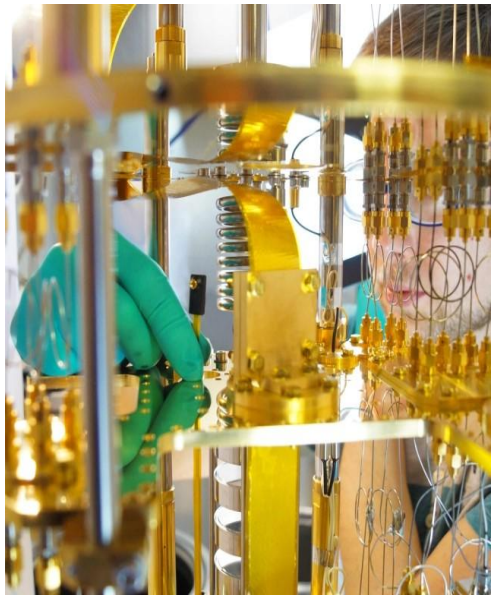


- IC先進3D封裝-- 多晶片(CPU、GPU、LOGIC…、記憶體多層推疊
  大面積一體封裝：THM、THL用於M社製程載體膜
- 載板、印刷電路板輕薄短小、高速化: TG 用於取代玻纖布

CONFIDENTIAL

PMR--Quantum Computer Business 又一驚艷實績



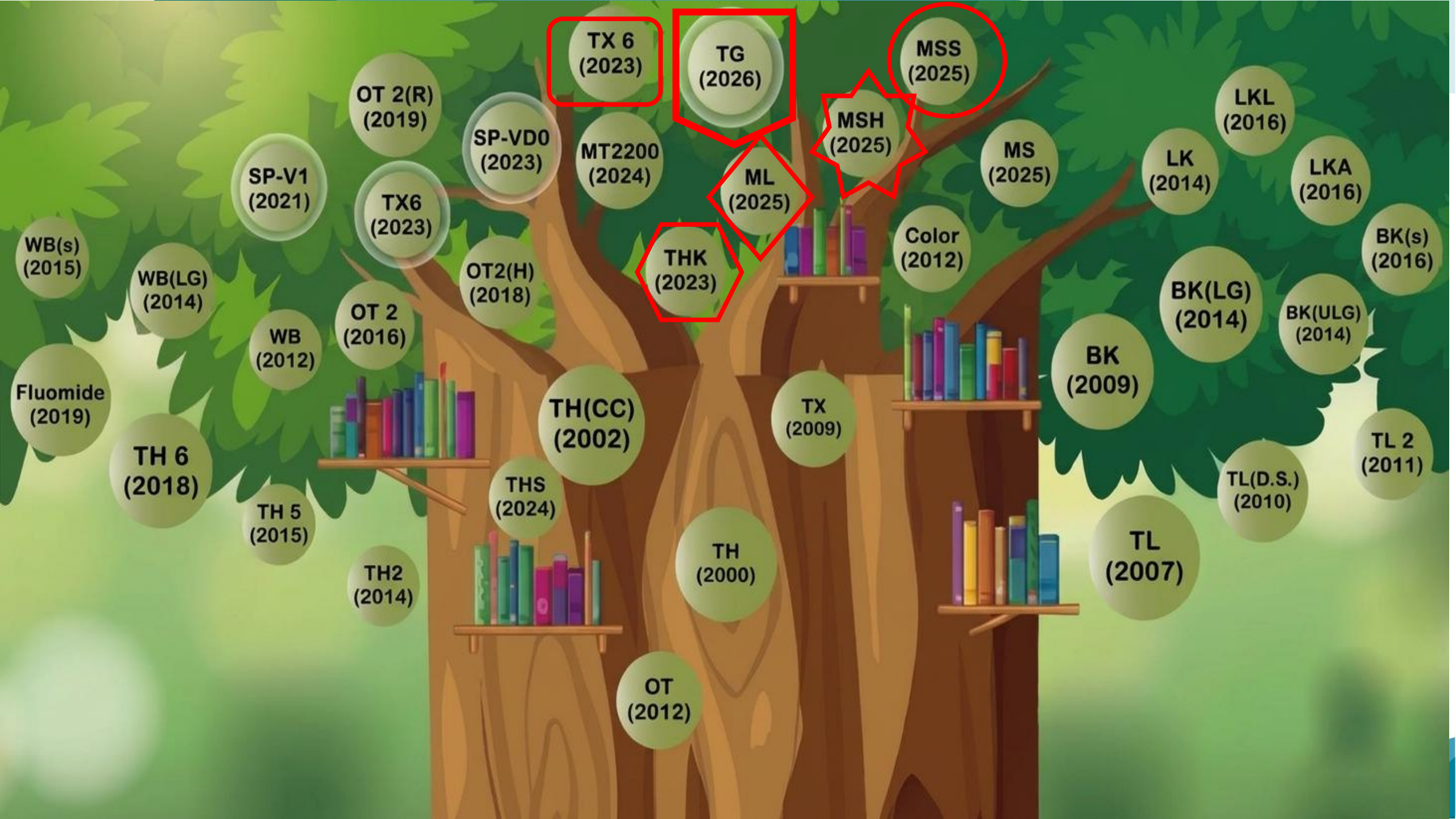




量子運算需在接近絕對零度的極低溫(-273)下維持「量子疊加態」，**PMR取得超導高速傳輸線(Metallied PI & Low Loss Trace)與歐洲廠商合作開發實績**，全新的高密度佈線（FPC）用以增加側載埠通道，及減少熱負荷。

Introducing High Density Flex Wiring (FPC)_1080p.mp4

CONFIDENTIAL


TX 6 (2023)
TG (2026)
MSS (2025)
OT 2(R) (2019)
SP-VD0 (2023)
MT2200 (2024)
MSH (2025)
LKL (2016)
SP-V1 (2021)
TX6 (2023)
ML (2025)
MS (2025)
LK (2014)
LKA (2016)
WB(s) (2015)
THK (2023)
Color (2012)
BK(s) (2016)
WB(LG) (2014)
OT2(H) (2018)
BK(LG) (2014)
OT 2 (2016)
BK(ULG) (2014)
WB (2012)
BK (2009)
Fluomide (2019)
TH(CC) (2002)
TX (2009)
TL 2 (2011)
TH 6 (2018)
THS (2024)
TL(D.S.) (2010)
TH 5 (2015)
TH (2000)
TL (2007)
TH2 (2014)
OT (2012)

問題與交流

CONFIDENTIAL

THE END

CONFIDENTIAL